

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務 — 我們的策略」一節。

### [編纂]用途

我們估計，我們將自[編纂]收取[編纂]淨額約[編纂]港元（經扣除[編纂]佣金、費用及我們就[編纂]應付的估計開支），假設[編纂]未獲行使以及[編纂]為每股[編纂][編纂]港元（即本文件所述指示性[編纂]的[編纂]）。

- 約[編纂]%的[編纂]淨額（[編纂]港元）將於未來五年用於研發工作，包括持續研發我們的光互連硬件及解決方案，以及光計算產品。根據我們的戰略，我們擬將該等[編纂]用於以下用途，但可根據不斷變化的業務需求及市場狀況作出調整：
  - **光互連硬件及解決方案的研發。**為鞏固我們的技術領先地位，我們計劃將約[編纂]%（[編纂]港元）的[編纂]淨額用於開發光互連硬件及解決方案，其中將重點加強半導體設計能力。
- **芯片設計技術研發：**約[編纂]%（[編纂]港元）將投資用於推進我們互連業務線的半導體設計。開發專有的互連芯片是我們競爭優勢的核心支柱，有助實現差異化性能表現及提升能源效率。

我們芯片設計技術的發展路線圖圍繞幾個遞進階段構建，從目前已商業化的線性可插拔光模塊(LPO)技術，到更先進的近封裝光學(NPO)及共封裝光學(CPO)技術，目標在於實現更短的電信號路徑、更低的功耗、更佳的性能及可擴展性。

具體而言，對於我們的Scale-up EPS，我們預計：(i)繼續現有Scale-up EPS用的PIC的開發，並在近期啟動一個新的PIC項目；及(ii)開發下一代芯片以支持我們的Scale-up EPS產品線，並設定中長期商業化目標。

對於Scale-up OCS，我們預計開發能夠支持顯著更大規模架構的下一代高密度基於NPO的Scale-up OCS解決方案。

對於我們的Scale-out技術，我們將繼續為正在進行的下一代PIC研發提供資金，其將支持交換機用CPO解決方案。

## 未來計劃及[編纂]用途

為持續及擴展我們的研發工作，我們將繼續投放資源以強化光互連半導體開發團隊。額外的光互連研發人員將專注於高速PIC設計、TIA / 驅動器芯片研發、相關硬件設計及計算相關軟件開發。

- **產品改進與商業化：**約[編纂]% ([編纂]港元) 將用於增強我們現有的光互連產品組合，並加速下一代商業產品的商業化進程。就Scale-up解決方案而言，我們將持續升級商業化的基於線性可插拔光模塊技術的硬件及解決方案以提升性能，同時開發將光互連與光交換相結合的下一代平台，以構建更大規模、更靈活的AI超節點。對於我們的scale-out產品線，我們將繼續利用我們自主研發的PIC改進並商業化我們的智能收發器產品。這些舉措將使我們處於業界從可插拔光學向共封裝架構轉型的前沿，拓寬我們光互連產品的商業化潛力。
- **光計算產品的研發。**我們計劃於未來五年內，將約[編纂]%，或[編纂]港元的[編纂]淨額用於持續研發光計算產品。
  - **PACE 3及下一代光學處理器之研發：**我們將把分配予光計算產品線的絕大部分[編纂]淨額，用於研發PACE 3及下一代光學處理器，其中，PACE 3為我們光計算產品線及商業化路線圖的核心。PACE 3將應用我們最新的專有光電架構，以克服傳統芯片的性能與能耗瓶頸，並為AI工作負載提供專屬加速能力。PACE 3的設計具備大幅擴充的光學矩陣及集成的高帶寬內存系統，旨在處理生成式AI中最嚴苛的工作負載。我們將投入內部研發資源，專注於設計強調更高計算精度、存儲與計算無縫集成，以及能在處理器集群間實現原生擴展的芯片架構。為支持開發，我們將使用部分[編纂]淨額採購工程設計、驗證及封裝服務，以加快PACE 3的研發時間表。我們亦將動用部分[編纂]，以採購工程設計、驗證及封裝服務，從而加速PACE 3光計算芯片的開發。此外，一旦PACE 3實現商業化，我們可能會將內部研發資源分配予未來一代的OPU，使我們能夠保持技術領先地位並支持長期商業化。我們計劃通過對前沿技術的持續投入，力爭維持在光計算領域的領先地位，並加快推進商業化路線圖的落地。

## 未來計劃及[編纂]用途

為支持光計算研發活動，我們將持續投放資源，擴充專注於光計算的科學家及工程師團隊。招聘將聚焦於半導體設計、軟件工程、系統設計及AI應用領域的專家，同時加強我們全球及內部的專業人才儲備。這些努力將助推光計算產品線的發展，並確保我們長期創新管線的持續推進。

- 約[編纂]%，或[編纂]港元的[編纂]淨額將用於我們的商業化工作。根據我們的戰略，我們擬將該等[編纂]淨額用於以下用途，但可根據我們不斷變化的業務需求及市場狀況的變動作出調整：
  - **擴充產品研發團隊。**我們計劃將約[編纂]% ([編纂]港元)的[編纂]淨額用於支持我們的產品研發及商業化工作。具體而言，我們計劃強化內部產品研發團隊，以加快光互連及光計算產品線的商業化。我們的商業化戰略不僅需要在芯片及系統層面持續實現技術突破，亦需具備強大的工程與部署能力，確保產品能匹配超大型數據中心及AI基礎設施運營商的多樣化需求。通過投入資源建設更強大的產品研發團隊，我們旨在縮短產品上市時間、保障產品在商業部署中的可靠性，並推動光互連與光計算這兩大核心產品引擎進一步擴展，獲得更多客戶的採用。
  - **擴充銷售及營銷團隊。**我們計劃將約[編纂]% ([編纂]港元)的所得款項淨額用於擴充我們的銷售及營銷團隊，支持產品的商業化。在團隊建設過程中，我們將緊密配合我們針對光互連產品的雙軌客戶獲取策略(涵蓋scale-up及scale-out解決方案)，以及我們針對光計算產品、旨在生態系統建設及最終大規模商業化的分階段路線圖。絕大部分[編纂]將分配予國內市場的國內銷售及營銷團隊，而一小部分[編纂]將分配予國際團隊，用於我們初期聚焦北美的海外市場探索。我們知悉海外市場存在獨特挑戰，且該等地區的需求驅動因素、客戶要求及用例可能與我們國內市場有顯著差異。例如，北美客戶對光互連解決方案的應用可能要求與我們當前產品不同的配置或性能規格。該等解決方案包括但不限於基於CXL的CPU及內存scale-up架構。在此階段，關於各海外市場的客戶群體、收入目標及時間表的具體細節仍保持靈活性。總體而言，我們的海外擴張將遵循分階段、嚴格的方式進行，且與我們在國內市場的擴張相比，將是我們增長戰略中相對較小的組成部分。隨著我們對各地區客戶需求及競爭格局有更深入的理解，我們將持續評估及完善我們的方法。
- 約[編纂]%，或[編纂]港元的[編纂]淨額將用於營運資金及一般企業用途。

---

## 未來計劃及[編纂]用途

---

倘[編纂]淨額並非即時需要用作上述用途，且在相關法律及法規允許的範圍內，我們只會將[編纂]淨額存放於持牌商業銀行及/或證券及期貨條例或相關司法管轄區適用法律所界定的其他認可金融機構的短期計息賬戶。倘上述建議[編纂]用途有任何變動，我們將刊發適當公告。